



## 平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年4月28日

上場取引所 東

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

コード番号 8035 URL <http://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 竹中 博司

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長

(氏名) 小俣 良二

TEL 03-5561-7000

定時株主総会開催予定日 平成23年6月17日

配当支払開始予定日

平成23年5月27日

有価証券報告書提出予定日 平成23年6月17日

決算補足説明資料作成の有無 : 有

決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成23年3月期の連結業績(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

#### (1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年3月期	668,722	59.7	97,870	—	101,919	—	71,924	—
22年3月期	418,636	△17.6	△2,180	—	2,558	△87.6	△9,033	—

(注) 包括利益 23年3月期 69,598百万円 (—%) 22年3月期 △4,750百万円 (—%)

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり 当期純利益	自己資本当期純利 益率	総資産経常利益率	売上高営業利益率
	円銭	円銭	%	%	%
23年3月期	401.73	401.06	13.3	13.5	14.6
22年3月期	△50.47	—	△1.8	0.4	△0.5

(参考) 持分法投資損益 23年3月期 ー百万円 22年3月期 ー百万円

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円銭
23年3月期	809,205	584,801	70.8	3,198.66
22年3月期	696,351	523,369	73.5	2,859.37

(参考) 自己資本 23年3月期 572,741百万円 22年3月期 511,818百万円

#### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
23年3月期	83,238	△35,881	△5,236	165,050
22年3月期	48,284	9,613	△287	123,939

### 2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産配当 率(連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円銭	円銭	円銭	円銭	円銭	百万円	%	%
22年3月期	—	4.00	—	8.00	12.00	2,147	—	0.4
23年3月期	—	38.00	—	76.00	114.00	20,412	28.4	3.8
24年3月期(予想)	—	—	—	—	—	—	—	—

(注)平成23年3月期の期末配当予想につきましては、本日公表の「平成23年3月期配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。また、平成24年3月期の第2四半期及び期末の配当につきましては、現段階では業績予想を精査中のため、未定としております。業績予想の開示とあわせ平成23年5月13日に公表する予定です。

### 3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

平成24年3月期の業績予想につきましては、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の直接、間接的な影響が刻々と変化しており、現在精査中のため記載しておりません。本件につきましては、想定しうる事象を考慮の上、平成23年5月13日に公表する予定です。

#### 4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 : 有

② ①以外の変更 : 無

(注) 詳細は、【添付資料】17ページ「3. 連結財務諸表(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数

23年3月期	180,610,911 株	22年3月期	180,610,911 株
23年3月期	1,554,231 株	22年3月期	1,614,225 株
23年3月期	179,035,910 株	22年3月期	178,987,481 株

#### (参考) 個別業績の概要

1. 平成23年3月期の個別業績(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年3月期	569,298	78.9	30,620	—	40,978	—	31,928	—
22年3月期	318,236	△18.3	△16,111	—	△13,985	—	△16,838	—

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
23年3月期	178.34	178.04
22年3月期	△94.08	—

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
23年3月期	629,215	359,135	56.8	1,997.34
22年3月期	533,081	334,495	62.5	1,859.91

(参考) 自己資本 23年3月期 357,636百万円 22年3月期 332,917百万円

#### ※ 監査手続の実施状況に関する表示

この決算短信は金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信開示時点においては、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続が終了していません。

#### ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

・当社は、平成23年5月13日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料につきましては、開催と同時に当社ホームページに掲載する予定です。

## 【添付資料】

## [目次]

1. 経営成績	2
(1) 経営成績に関する分析	2
(2) 財政状態に関する分析	5
(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当	6
2. 経営方針	7
(1) 会社の経営の基本方針	7
(2) 会社の対処すべき課題	7
3. 連結財務諸表	9
(1) 連結貸借対照表	9
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	11
(3) 連結株主資本等変動計算書	13
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	16
(5) 継続企業の前提に関する注記	17
(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更	17
(7) 連結財務諸表に関する注記事項	18
(連結包括利益計算書関係)	18
(セグメント情報)	18
(1株当たり情報)	20
(重要な後発事象)	20
4. その他	21
(1) 生産、受注及び販売の状況	21

## 1. 経営成績

### (1) 経営成績に関する分析

#### ① 当連結会計年度の事業環境

当連結会計年度の世界経済につきましては、全体として回復基調で推移しました。欧米では、一部の地域で停滞しましたが、期後半からは総じて景気回復傾向が見られました。アジアでは、中国、インドなど新興国の内需を中心に景気が拡大いたしました。また、日本経済は景気持ち直しの動きを示すものの、円高の影響や厳しい雇用環境等により足踏み状態が続いており、3月の東日本大震災による影響も懸念されております。

当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業に関しましては、期前半までは好調であったパソコン、薄型テレビ等が調整局面に入っておりますが、スマートフォン、タブレット PC などの伸長著しい民生電子機器需要に支えられ、これらの基幹部品である半導体、FPD 関連市場は概ね順調でした。

#### ② 当連結会計年度の損益の状況

このような状況のもと、当社グループは高付加価値製品の市場投入・拡販に積極的に取り組み、売上、利益ともに前連結会計年度から大きく回復いたしました。当連結会計年度の損益の状況は以下のとおりであります。

当連結会計年度の売上高は6,687億2千2百万円(前連結会計年度比59.7%増)となりました。国内売上高が1,821億6千5百万円(前連結会計年度比12.0%増)、海外売上高が4,865億5千7百万円(前連結会計年度比90.0%増)となり、連結売上高に占める海外売上高の比率につきましては72.8%となりました。なお、当連結会計年度の受注高は7,348億9千3百万円(前連結会計年度比53.6%増)となり、当連結会計年度末の受注残高は3,088億9百万円(前連結会計年度末比27.3%増)となりました。

なお、当社グループにおきましても東日本大震災の影響により、工場の一部において建物及び設備の軽微な損傷等が発生し、一時的に生産・出荷が停止いたしました。当連結会計年度の売上及びたな卸資産等への大きな影響はありませんでした。

売上原価は4,339億6千3百万円(前連結会計年度比39.8%増)、売上総利益は2,347億5千8百万円(前連結会計年度比116.7%増)となりました。この結果、売上総利益率は35.1%(前連結会計年度比9.2ポイント増)となりました。

販売費及び一般管理費は1,368億8千7百万円(前連結会計年度比23.9%増)となり、連結売上高に対する比率は20.5%(前連結会計年度比5.9ポイント減)となりました。

これらの結果、営業利益は978億7千万円(前連結会計年度は21億8千万円の営業損失)となりました。経常利益は、営業外収益48億2千7百万円、営業外費用7億7千8百万円を加減し1,019億1千9百万円(前連結会計年度は25億5千8百万円)となりました。

特別損益に関しましては、貸倒引当金戻入額などの特別利益21億3千4百万円と特別損失44億7千5百万円を計上し23億4千万円の損失(前連結会計年度は103億2千6百万円の損失)となりました。特別損失の主な内容といたしましては、震災関連損失11億1千3百万円、宮城新工場移転関連費用18億3千9百万円であります。

税金等調整前当期純利益は995億7千9百万円(前連結会計年度は77億6千7百万円の税金等調整前当期純損失)、当期純利益は719億2千4百万円(前連結会計年度は90億3千3百万円の当期純損失)となりました。

この結果、1株当たり当期純利益は401円73銭(前連結会計年度は50円47銭の1株当たり当期純損失)となりました。

## ③ 当連結会計年度のセグメント別営業概況

## 《半導体製造装置》

スマートフォンやタブレットPC等の新しいアプリケーションへの半導体用途の拡大により、フラッシュメモリーやロジック半導体向けを中心に半導体市場は急回復いたしました。期後半からはパソコンの需要減速に伴いDRAM市場がやや弱含みとなりましたが、特に前工程の設備投資は前連結会計年度に比べ大幅に増加いたしました。また、コータ/デベロッパ「CLEAN TRACK® LITHIUS Pro® V」、プラズマエッチング装置「Tactras® Vigus®」、熱処理成膜装置「TELINDY PLUS®」などの最新モデルの拡販に積極的に取り組んだ結果、当セグメントの当連結会計年度における外部顧客に対する売上高は、5,113億3千1百万円(前連結会計年度比94.9%増)となりました。

## 《FPD/PV(フラットパネルディスプレイ及び太陽電池)製造装置》

FPD製造装置を取り巻く環境につきましては、大型液晶パネル市場は在庫調整局面を迎えておりますが、中小型液晶パネルはスマートフォン、タブレットPCの旺盛な需要に支えられ、設備投資が活発化してきており、全体としては底堅く推移しました。また、太陽電池製造装置分野につきましては、当社が参入する薄膜シリコン型市場は未だ黎明期ではありますが、世界的なエネルギー政策の見直しが進むなか、中長期的には市場の大きな成長が見込まれております。このような状況のもと、当セグメントの当連結会計年度における外部顧客に対する売上高は、667億2千1百万円(前連結会計年度比6.5%減)となりました。

## 《電子部品・情報通信機器》

半導体及び電子デバイス分野では、薄型テレビや周辺機器を含むデジタル家電等の民生機器関連に係る半導体製品については、年明け以降低水準で推移する傾向となりました。一方で、医療機器、半導体製造装置及びFA機器等の産業機器関連に対する需要は順調に推移したことから、アナログICやカスタムICの売上が伸びました。コンピュータシステム関連分野では、コンピュータ・ネットワーク関連機器の製品販売が伸び悩んだものの、組み込み機器向けソフトウェアの販売が好調であり、保守サービスビジネスも堅調に推移しました。このような状況のもと、当セグメントの当連結会計年度における外部顧客に対する売上高は、902億1千6百万円(前連結会計年度比6.8%増)となりました。

## 《その他》

当セグメントの当連結会計年度における外部顧客に対する売上高は、4億5千3百万円(前連結会計年度比10.4%増)となりました。

※当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。このため、各セグメントの外部顧客に対する売上高の前連結会計年度との比較については、前連結会計年度の数値を適用後の報告セグメントの区分に組み替えて算出しております。

(ご参考)【連結】

(単位:百万円)

平成23年3月期	上半期		上半期	下半期		通期	平成22年 3月期	
	第1Q	第2Q		第3Q	第4Q			
売上高	144,889	173,510	318,400	159,662	190,658	350,321	668,722	418,636
半導体製造装置	103,166	137,063	240,229	115,373	155,728	271,101	511,331	262,391
日本	18,404	28,547	46,952	16,927	24,060	40,988	87,940	44,174
米国	17,552	22,474	40,026	20,974	41,897	62,871	102,898	55,555
欧州	2,942	7,028	9,970	5,609	12,902	18,511	28,482	10,937
韓国	21,445	30,126	51,571	17,092	19,194	36,287	87,858	44,716
台湾	34,014	37,082	71,097	35,383	43,802	79,185	150,282	76,795
中国	4,649	5,195	9,844	7,960	7,787	15,748	25,593	7,616
東南アジア他	4,158	6,608	10,766	11,424	6,084	17,509	28,275	22,595
F P D / P V 製造装置	20,306	12,553	32,860	21,992	11,867	33,860	66,721	71,361
電子部品・情報通信機器	21,321	23,754	45,075	22,222	22,917	45,140	90,216	84,473
その他	95	138	234	73	145	218	453	410
営業利益(△損失)	18,321	24,020	42,342	25,815	29,713	55,528	97,870	△2,180
経常利益	19,063	26,043	45,107	26,667	30,145	56,812	101,919	2,558
当期(四半期)純利益(△損失)	14,727	18,726	33,454	18,667	19,802	38,470	71,924	△9,033

(注)セグメント間取引については、相殺消去しております。

## ④ 次期(平成24年3月期)の見通し

平成24年3月期の業績予想につきましては、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の直接、間接的な影響が刻々と変化しており、現在精査中のため記載しておりません。本件につきましては、想定しうる事象を考慮の上、平成23年5月13日に公表する予定です。

## (2) 財政状態に関する分析

## ① 財政状態

当連結会計年度末の流動資産は、前連結会計年度末から912億9千2百万円増加し、6,442億3千1百万円となりました。主な内容としましては、有価証券に含まれる譲渡性預金の増加450億5千7百万円、たな卸資産の増加304億7千5百万円であります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から204億2千4百万円増加し、1,125億5千1百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から13億7千3百万円減少し、42億1千2百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から25億1千万円増加し、482億9百万円となりました。

これらを合計した総資産は、前連結会計年度末から1,128億5千3百万円増加の8,092億5百万円となりました。

流動負債は前連結会計年度末から488億7千6百万円増加し、1,680億3千8百万円となりました。主な内容としましては、未払法人税等の増加209億7千2百万円、前受金の増加98億4千7百万円であります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ25億4千5百万円増加の563億6千5百万円となりました。

純資産は、当期純利益719億2千4百万円を計上したことによる増加、前期の期末配当14億3千1百万円及び当期の中間配当68億4百万円の実施による減少等の結果、前連結会計年度末から614億3千2百万円増加の5,848億1百万円となり、また自己資本比率は70.8%となりました。

## ② キャッシュ・フロー

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の1,239億3千9百万円から411億1千万円増加の1,650億5千万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない預入期間3ヶ月超の定期預金及び譲渡性預金1,200億円を加えた残高は、2,850億5千万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況等は、次のとおりであります。

営業活動により獲得したキャッシュ・フローにつきましては、前連結会計年度に比べ349億5千3百万円増加の832億3千8百万円となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益995億7千9百万円、減価償却費177億7百万円、前受金の増加95億7千5百万円がそれぞれキャッシュ・フローのプラス要因となった一方、たな卸資産の増加365億3千2百万円、売上債権の増加133億1千9百万円及び法人税等の支払額75億8千3百万円がそれぞれキャッシュ・フローのマイナス要因となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に有形固定資産の取得による支出335億4千1百万円により、前連結会計年度の96億1千3百万円の収入に対し、358億8千1百万円の支出となりました。

財務活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払82億3千6百万円により、前連結会計年度の2億8千7百万円に対し、52億3千6百万円となりました。

## (参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成22年3月期	平成23年3月期
自己資本比率(%)	73.5	70.8
時価ベースの自己資本比率(%)	159.4	101.5
キャッシュ・フロー対有利子負債倍率(倍)	0.1	0.1
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	1047.59	1824.28

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債倍率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※ 各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※ 株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式数により計算しております。

※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

## (3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、連結当期純利益に対する配当性向20%を目標とすることを株主還元の基本方針としてまいりましたが、平成22年11月2日開催の取締役会において、平成23年3月期期末配当から連結当期純利益に対する配当性向35%を目標とする方針に変更することといたしました。

当社は、利益成長を通じて企業価値向上を図るべく、内部留保資金を有効活用し、成長分野に重点的に投資するとともに、業績連動型・収益対応型配当により、株主各位に対して直接還元をしてまいりました。将来の成長の礎となる研究開発・設備・人材への投資につきましては、引き続き積極的に実施する方針に変更ありませんが、事業や財務状況に関する中期的見通しを検討した結果、より積極的な株主還元策として連結配当性向を引き上げることといたしました。

当期(平成23年3月期)におきましては、中間配当として1株につき38円といたしました。期末配当につきましては、下半期の連結業績に上記新方針を適用し、1株につき76円を予定しております。これにより、当期の年間配当金は、中間配当金を含め1株当たり114円となる予定です。

次期(平成24年3月期)の配当につきましては、現段階では業績予想を精査中のため未定としておりますが、業績予想の開示とあわせ、平成23年5月13日に公表する予定です。



## 2. 経営方針

### (1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、利益志向経営のもと、顧客第一主義、製品開発力・技術開発力の向上及び従業員の活性化に取り組むことによって、企業価値の向上を実現することを経営の基本方針としております。

こうした基本方針のもと、当社グループは、強い国際競争力、高い成長力、高い収益力を備え、活力あふれる力強い企業作りを推進し、当社株式が投資家各位にとって魅力あるものにしていきたいと考えております。

### (2) 会社の対処すべき課題

技術革新の激しいエレクトロニクス産業の中で、半導体及びFPD製造装置のリーディングサプライヤーとして、積極的にビジネスを展開しております当社グループの基本理念は次のとおりであります。

人々の健全で質の高い生活を実現し、夢のある社会を構築するために、当社グループは先端分野におけるトップサプライヤーとして価値の高い技術・サービスを世界に提供し、環境問題に対しても一層のリーダーシップを発揮する。このような使命感を社員全員と共有し、いきいきと輝き、夢と活力のある会社の実現を目指す。

またこの基本理念のもと、経営方針として以下の項目を掲げております。

1. 技術革新を創造するイノベーション・カンパニーの構築
2. 国際競争力を持つグローバル・リーダーの追求
3. 顧客ニーズに対応したベスト・ソリューションの提供
4. 環境問題へのグローバルな対応、貢献

当社グループといたしましては、上記経営方針に基づき、次の重点施策に取り組んでまいります。

#### ① 研究開発力の強化

より豊かな社会を実現するための技術革新を生み出し、競争力ある新製品をタイムリーに市場へ投入していくためには、研究開発力の維持・向上が欠かせません。当社グループは、半導体・FPD製造装置のより高い成長の期待できる分野を中心に、次世代技術、差別化技術の開発に注力するとともに、長年培ってきた技術を生かし、有機EL製造装置や太陽電池製造装置などの新たな事業分野の開拓・育成にも一層力を入れ、高付加価値製品の提供を行ってまいります。

#### ② 「モノづくり力」の強化

当社グループでは、開発・量産機能を一貫体制とし、製造コストの削減、製造期間の短縮、品質向上の実現に向けて、「モノづくり力」の強化を推進するとともに、高付加価値製品の開発期間の更なる短縮化を図っております。現在、宮城県黒川郡大和町で新工場の建設を進めておりますが、この宮城新工場では、今後の市場規模拡大とシェア向上が期待される半導体用のエッチング装置の開発から量産までを一貫して行います。また、生産方式の改革により、生産性の向上と工期短縮を目指すとともに、新プラズマ技術であるRLSAを用いた装置の量産も行なってまいります。

加えて、中国などアジアのFPD製造装置需要に対するタイムリーな製品・サービスの提供とコスト競争力の強化を図るため、中国江蘇省昆山市にFPD製造装置事業の新生産拠点建設を進めております。

### ③ ベスト・ソリューションの提供強化

営業・サービス体制のみならず、開発においても、米国ニューヨーク州、台湾新竹市等での海外開発拠点展開及び欧米の研究機関との連携強化など、各顧客とのパートナーシップ強化に取り組んでおり、韓国においても新たな開発拠点の開設を計画しております。また、顧客の幅広い技術要求に対する迅速かつ的確な提案力を高めるため、当社グループの装置プロダクトの組み合わせを生かすとともに、フィールドエンジニアをより上流である各生産拠点の組織内に組み入れるなどの取り組みを行っております。さらに、最新鋭装置の営業・販売に加え、既に販売した装置の移設、改造、性能向上などに対応するフィールドソリューション事業を強化してまいります。

### ④ 環境問題への取り組み

当社グループの事業活動や物流などに対する環境負荷低減活動を推進するとともに、顧客工場での総合環境負荷を平成19年のベースから平成27年までに半減するため、温室効果ガスの排出量削減及び装置使用時の電力、水の使用量削減を実現する製造装置の開発を進め、業界全般にわたる環境対策に貢献してまいります。

以上の施策に加え、成長の源泉となる人的資源に関しましては、あらゆるビジネス環境の変化に対応できる人材を育成するため、今後も適材適所の人材配置を実施し、能力開発プログラムの充実に積極的に取り組み、当社グループの飛躍に繋げてまいります。また、貢献度に応じた公正な評価・報酬制度を整備し、夢と活力に満ちた会社を実現してまいります。

なお、3月に発生した東日本大震災に関しましては、当社グループの生産拠点への影響は軽微であり、現在復旧対応中ではありますが、サプライチェーンや東京電力管内を中心とした電力不足懸念への対応等も含め、グループ一丸となって取り組んでまいります。

当社グループは、利益志向経営のもと、顧客第一主義、製品開発力・技術開発力の向上、国際競争力の強化及び従業員の活性化に取り組むことによって、今後も企業価値の向上を推進してまいります。

3. 連結財務諸表  
 (1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	56,939	52,992
受取手形及び売掛金	124,462	136,385
有価証券	187,000	232,057
商品及び製品	87,201	111,918
仕掛品	37,793	43,246
原材料及び貯蔵品	13,455	13,760
繰延税金資産	26,625	27,609
その他	19,638	27,414
貸倒引当金	△176	△1,153
流動資産合計	552,939	644,231
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	120,429	121,597
減価償却累計額	△75,001	△75,363
建物及び構築物 (純額)	45,428	46,234
機械装置及び運搬具	70,036	75,735
減価償却累計額	△56,854	△58,755
機械装置及び運搬具 (純額)	13,182	16,980
土地	26,355	25,772
建設仮勘定	3,739	19,509
その他	28,906	28,963
減価償却累計額	△25,484	△24,909
その他 (純額)	3,421	4,054
有形固定資産合計	92,127	112,551
無形固定資産		
その他	5,586	4,212
無形固定資産合計	5,586	4,212
投資その他の資産		
投資有価証券	14,720	15,725
繰延税金資産	20,505	20,727
その他	17,924	13,786
貸倒引当金	△7,452	△2,031
投資その他の資産合計	45,698	48,209
固定資産合計	143,412	164,973
資産合計	696,351	809,205

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	52,359	53,612
未払法人税等	—	25,328
賞与引当金	6,043	11,130
製品保証引当金	5,267	7,594
その他	55,490	70,372
流動負債合計	119,161	168,038
固定負債		
退職給付引当金	49,906	52,230
その他	3,913	4,134
固定負債合計	53,820	56,365
負債合計	172,982	224,403
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,034	78,045
利益剰余金	393,970	457,658
自己株式	△10,900	△10,484
株主資本合計	516,065	580,180
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,504	2,807
繰延ヘッジ損益	△67	△12
為替換算調整勘定	△6,683	△10,234
その他の包括利益累計額合計	△4,247	△7,439
新株予約権	1,578	1,499
少数株主持分	9,973	10,560
純資産合計	523,369	584,801
負債純資産合計	696,351	809,205

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書  
連結損益計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
売上高	418,636	668,722
売上原価	310,320	433,963
売上総利益	108,316	234,758
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	18,084	19,938
賞与引当金繰入額	1,765	3,243
退職給付引当金繰入額	2,358	2,222
その他の人件費	6,400	8,872
減価償却費	5,605	4,386
研究開発費	54,074	70,568
その他	22,208	27,655
販売費及び一般管理費合計	110,496	136,887
営業利益又は営業損失(△)	△2,180	97,870
営業外収益		
受取利息	993	612
補助金収入	1,842	3,026
その他	2,494	1,188
営業外収益合計	5,331	4,827
営業外費用		
建物解体関連費用	—	226
閉鎖拠点維持管理費用	—	185
投資有価証券評価損	185	—
固定資産賃貸費用	103	—
為替差損	—	143
その他	302	222
営業外費用合計	591	778
経常利益	2,558	101,919
特別利益		
貸倒引当金戻入額	—	1,891
固定資産売却益	282	—
その他	17	242
特別利益合計	299	2,134
特別損失		
固定資産除売却損	977	624
減損損失	7,553	810
災害による損失	—	1,113
工場移転費用	—	1,839
拠点統廃合関連費用	1,908	—
その他	186	86
特別損失合計	10,626	4,475
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	△7,767	99,579
法人税、住民税及び事業税	5,747	29,482
法人税等調整額	△5,020	△2,711
法人税等合計	726	26,771
少数株主損益調整前当期純利益	—	72,807
少数株主利益	539	883
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,033	71,924

## 連結包括利益計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	—	72,807
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	—	303
繰延ヘッジ損益	—	71
為替換算調整勘定	—	△3,584
その他の包括利益合計	—	△3,209
包括利益	—	69,598
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	—	68,732
少数株主に係る包括利益	—	866

## (3) 連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	54,961	54,961
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	54,961	54,961
資本剰余金		
前期末残高	78,114	78,034
当期変動額		
自己株式の処分	△79	11
当期変動額合計	△79	11
当期末残高	78,034	78,045
利益剰余金		
前期末残高	404,435	393,970
当期変動額		
剰余金の配当	△1,431	△8,236
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,033	71,924
当期変動額合計	△10,465	63,688
当期末残高	393,970	457,658
自己株式		
前期末残高	△11,111	△10,900
当期変動額		
自己株式の取得	△58	△37
自己株式の処分	270	453
当期変動額合計	211	415
当期末残高	△10,900	△10,484
株主資本合計		
前期末残高	526,398	516,065
当期変動額		
剰余金の配当	△1,431	△8,236
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,033	71,924
自己株式の取得	△58	△37
自己株式の処分	190	464
当期変動額合計	△10,333	64,115
当期末残高	516,065	580,180

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
その他の包括利益累計額		
その他の有価証券評価差額金		
前期末残高	△842	2,504
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	3,346	303
当期変動額合計	3,346	303
当期末残高	2,504	2,807
繰延ヘッジ損益		
前期末残高	66	△67
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△134	55
当期変動額合計	△134	55
当期末残高	△67	△12
為替換算調整勘定		
前期末残高	△7,235	△6,683
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	551	△3,550
当期変動額合計	551	△3,550
当期末残高	△6,683	△10,234
その他の包括利益累計額合計		
前期末残高	△8,011	△4,247
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	3,764	△3,192
当期変動額合計	3,764	△3,192
当期末残高	△4,247	△7,439
新株予約権		
前期末残高	1,148	1,578
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	429	△78
当期変動額合計	429	△78
当期末残高	1,578	1,499
少数株主持分		
前期末残高	9,729	9,973
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	244	587
当期変動額合計	244	587
当期末残高	9,973	10,560



(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
純資産合計		
前期末残高	529,265	523,369
当期変動額		
剰余金の配当	△1,431	△8,236
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,033	71,924
自己株式の取得	△58	△37
自己株式の処分	190	464
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	4,438	△2,683
当期変動額合計	△5,895	61,432
当期末残高	523,369	584,801

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	△7,767	99,579
減価償却費	20,001	17,707
減損損失	7,553	810
退職給付引当金の増減額(△は減少)	2,828	2,342
貸倒引当金の増減額(△は減少)	120	△4,341
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,078	5,086
製品保証引当金の増減額(△は減少)	△836	2,352
受取利息及び受取配当金	△1,055	△696
固定資産除却損	916	—
売上債権の増減額(△は増加)	△4,890	△13,319
たな卸資産の増減額(△は増加)	△4,868	△36,532
仕入債務の増減額(△は減少)	27,975	1,667
未収消費税等の増減額(△は増加)	568	△8,025
未払消費税等の増減額(△は減少)	—	2,304
前受金の増減額(△は減少)	△6,380	9,575
破産更生債権等の増減額(△は増加)	△139	5,302
その他	6,377	6,308
小計	41,480	90,121
利息及び配当金の受取額	1,171	745
利息の支払額	△46	△45
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	5,679	△7,583
営業活動によるキャッシュ・フロー	48,284	83,238
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△449,000	△360,000
定期預金の払戻による収入	473,347	360,000
有形固定資産の取得による支出	△14,194	△33,541
有形固定資産の売却による収入	488	509
無形固定資産の取得による支出	△786	△925
その他	△241	△1,923
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,613	△35,881
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	1,299	2,890
自己株式の純増減額(△は増加)	131	427
配当金の支払額	△1,431	△8,236
その他	△286	△318
財務活動によるキャッシュ・フロー	△287	△5,236
現金及び現金同等物に係る換算差額	445	△1,009
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	58,056	41,110
現金及び現金同等物の期首残高	65,883	123,939
現金及び現金同等物の期末残高	123,939	165,050

(5) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

会計方針の変更

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

## (7) 連結財務諸表に関する注記事項

## (連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度(自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日)

当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

親会社株主に係る包括利益	△5,269百万円
少数株主に係る包括利益	518百万円
計	△4,750百万円

当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

その他有価証券評価差額金	3,349百万円
繰延ヘッジ損益	△151百万円
為替換算調整勘定	545百万円
計	3,743百万円

## (セグメント情報)

## ① 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」、「FPD/PV(フラットパネルディスプレイ及び太陽電池)製造装置」及び「電子部品・情報通信機器」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、プラズマエッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD/PV製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、プラズマエッチング/アッシング装置及び薄膜シリコン太陽電池用のプラズマCVD装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「電子部品・情報通信機器」は、集積回路(IC)を中心とした半導体製品、その他電子部品、コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア等の設計・開発・仕入・販売等を行っております。

## ② 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表の作成方法と概ね同一であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

また、共用資産については、各報告セグメントに配分しておりませんが、関連する費用については、合理的な基準に基づき各報告セグメントに配分しております。

## ③ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

当連結会計年度(自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日)

(単位：百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	F P D / P V 製造装置	電子部品・ 情報通信機器				
売上高							
外部顧客への 売上高	511,331	66,721	90,216	453	668,722	-	668,722
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	0	-	1,099	14,907	16,007	△16,007	-
計	511,331	66,721	91,315	15,361	684,729	△16,007	668,722
セグメント利益	120,845	6,640	2,907	1,916	132,309	△32,730	99,579
セグメント資産	239,707	42,812	50,254	2,093	334,868	474,336	809,205
その他の項目							
減価償却費	7,369	543	455	353	8,721	8,985	17,707
有形固定資産及び 無形固定資産の 増加額	13,181	553	774	27	14,536	26,723	41,260

(注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの製品等の輸送、機器等のリース及び保険業務等を含んでおります。

2. 調整額の主な内容は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額△32,730 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△22,718 百万円であります。

(2) セグメント資産の調整額 474,336 百万円の主な内容は、各報告セグメントに配分していない現金及び預金、有価証券、建物及び構築物等であります。

(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額 26,723 百万円の主な内容は、各報告セグメントに配分していない建物及び構築物の設備投資額であります。

3. セグメント利益は、連結損益計算書の税金等調整前当期純利益と調整を行っております。

## (追加情報)

当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第 17 号 平成 21 年 3 月 27 日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 20 号 平成 20 年 3 月 21 日)を適用しております。

## (1 株当たり情報)

項 目	当連結会計年度 (自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日)
1 株当たり純資産額	3,198 円 66 銭
1 株当たり当期純利益	401 円 73 銭
潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益	401 円 06 銭

(注) 1 株当たり当期純利益及び潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

連結損益計算書上の当期純利益(百万円)	71,924
普通株式に係る当期純利益(百万円)	71,924
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(百万円)	—
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—
普通株式の期中平均株式数(千株)	179,035
潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益の算定に用いられた 当期純利益調整額の主要な内訳(百万円)	—
当期純利益調整額(百万円)	—
潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益の算定に用いられた 普通株式増加数の主要な内訳(千株)	
新株予約権	297
普通株式増加数(千株)	297
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要	新株予約権 5 種類(新株予約権の数 10,771 個)。

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 4. その他

## (1) 生産、受注及び販売の状況

## ① 生産実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	前連結会計年度 〔 自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日 〕	当連結会計年度 〔 自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日 〕
	生産高	生産高
半 導 体 製 造 装 置	263,955	507,161
F P D / P V 製 造 装 置	66,318	74,016
合 計	330,274	581,177

- (注) 1. 金額は販売価格によっております。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## ② 受注実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	前連結会計年度 〔 自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日 〕		当連結会計年度 〔 自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日 〕	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
半 導 体 製 造 装 置	360,914	172,303	567,971	228,942
F P D / P V 製 造 装 置	28,566	56,778	75,433	65,491
電 子 部 品 ・ 情 報 通 信 機 器	88,549	13,555	91,035	14,375
そ の 他	410	—	453	—
合 計	478,440	242,637	734,893	308,809

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## ③ 販売実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	前連結会計年度 〔 自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日 〕	当連結会計年度 〔 自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日 〕
	販売高	販売高
半 導 体 製 造 装 置	262,391	511,331
F P D / P V 製 造 装 置	71,361	66,721
電 子 部 品 ・ 情 報 通 信 機 器	84,473	90,216
そ の 他	410	453
合 計	418,636	668,722

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

※当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。このため、前連結会計年度との比較については、前連結会計年度の数値を適用後の報告セグメントの区分に組み替えて算出しております。